

STOL®155 – C15500



应用范围

合金适用于印刷电路板（PCB）组件或焊接应用；具有中等强度、高导电性、高的抗软化和抗氧化性能。

物理性能

密度	克/厘米 ³	8,91
导热性	瓦/(米·开)	346
导电性	毫西门子/米	50
导电性	IACS (%)	86
热膨胀系数	10 ⁻⁶ K	17,8
弹性模量	千兆帕	115

化学成分(%)

铜（包括银）	余量
镁	0,08 – 0,13
磷	0,04 – 0,08
银	0,027 – 0,10

状态	强度等级	抗拉强度	屈服强度	延伸率	延伸率	导电性	弯曲性能	
		抗拉强度 最小值-最大值 兆帕	R _{p 0,2} 最小值 兆帕				R/t ^{1) 2)} 90°	R/t ^{1) 2)} 90°
				最小值 %		毫西门子/米	好方向 铜带厚度 ≤0,5 毫米	坏方向 铜带厚度 ≤0,5 毫米
冷加工硬化	R235	235 – 295	105	30		50	0	0
冷加工硬化	R310	310 – 380	260	13		50	0	0
冷加工硬化	R385	385 – 440	345	6		50	0	0,5
冷加工硬化	R435	435 – 495	385	5		50	0,5	1
冷加工硬化	R450	450 – 505	415	4		50	0,5	1
冷加工硬化	R470	470 – 515	435	3		50	1	2

* 室温下的参考值

** 温度范围 20 – 300 °C

*** 最低强化状态下的数值

³⁾ 应力消除状态下的数值

¹⁾ $r = x \cdot t$ (适用于铜带厚度 $t < 1$) ²⁾ 样品宽度=10mm/可以根据要求在更窄的宽度进行弯曲测试 (评估方法依据手册页5.4.2)

免责声明: 由于生产工艺可能的变更及差异, 本手册及数据表上的公布的信息不能保证。本公司保留更改、修订上述内容的权利。因所提供的信息造成的任何问题, 本公司不承担任何责任。

版次: 09/2016

KMD集团上海分公司

新华路664号万宝国际商务中心433室
上海市
中国

电子邮件:

电话: +86 21 64478680

传真: +86 21 62256851

<http://www.kmdgroup.com/>